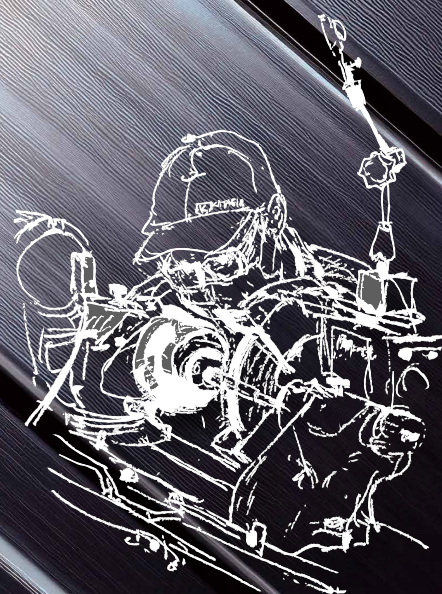


出展のご案内

現場の答えが見つかる
研削加工の専門展示会

Grinding
Technology
Japan
2027 研削加工技術と
工具製造技術展



2027.3.10(水) ▶ 3.12(金)

10:00-17:00 幕張メッセ

メルマガの
登録はこちら



主催／日本工業出版 産経新聞社
www.gtj-expo.jp

ご挨拶

2027年3月10日(水)から12日(金)までの3日間、千葉県・幕張メッセにて「Grinding Technology Japan (GTJ) 2027」を開催いたします。

GTJは、工具製造技術および研削加工技術に特化した専門展示会として、2019年に第1回を開催いたしました。以来、2年に1度のペースで開催を重ね、今回で第5回目を迎えます。

本展示会は高度な専門性を有するイベントであることから、来場者はこの分野の専門家が中心となっており、出展各社からは「来場者の質が非常に高い」との高評価をいただいております。

2027年の開催では、アジアと欧州からの出展が増加し、一層グローバルなイベントとなる見込みです。

このグローバルな拡大は、参加者にとって新たなビジネス機会と知見をもたらす、イベント全体の価値をさらに高めるものと確信しております。

国際色を一層強める第5回GTJ2027に、ぜひご期待ください。

開催概要

会 期 2027年3月10日(水)～12日(金)

開場時間 10:00～17:00

会 場 幕張メッセ 展示ホール7-8(予定)

入 場 料 2,000円(ただし招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料)

主 催 日本工業出版(株)
(株)産経新聞社

企 画 日本工業出版(株)「機械と工具」編集部

後 援 在日ドイツ連邦共和国大使館(予定)

特別協賛 切削フォーラム21

特別協力 (公社)砥粒加工学会

協 賛 日本工作機械工業会、日本工作機械輸入協会、日本工作機械販売協会、日本鍛圧機械工業会、日本精密機械工業会、日本機械工具工業会、日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、ダイヤモンド工業協会、日本光学測定機工業会、日本フルードパワー工業会、日本試験機工業会、日本歯車工業会、精密工学会、日本フルードパワーシステム学会、ターボ機械協会、日本機械鋸・刃物工業会、全国機械用刃物研磨工業協同組合、日本包丁研ぎ協会、バリ取り・表面仕上げ・洗浄協会(予定)



出展対象

- 研削盤 ●研磨盤 ●砥石 ●ツルージング装置 ●計測機器 ●周辺機器 ●研削工具 ●工具研削盤 ●切削工具
- 切削工具製造技術 ●切削工具活用技術 ●研削油 ●研削油供給装置 ●研削油ろ過装置 他

来場対象

研削加工技術者・研究者、工具製造者、研削加工業者、学生、他

同時開催(一部予定含む)

- 砥粒加工学会 先進テクノフェア(ATF2027)
- 研削コンシェルジュ
- 砥粒加工学会ポスター展
- 製品・技術説明会



同時開催 「先進パワー半導体ウエハ加工技術展2027」

2027年3月10日(水)～12日(金)
幕張メッセにて開催!

出展対象 先進パワー半導体ウエハ関連加工装置(スライシング、研削・研磨、ラッピング、ポリッシング、CMP、ベベリングなど)、関連工具・資材(砥石、研磨パッド、研磨スラリー)、ウエハ洗浄装置、ウエハ測定・評価装置

来場対象 先進パワー半導体単結晶成長技術者・研究者、先進パワー半導体ウエハ加工技術者・研究者、先進パワー半導体ウエハ評価技術者・研究者、学生、他

早期申込締切 **2026年5月29日(金)まで**

申込締切 **2026年9月30日(水)**

出展要項

Aタイプ

出展小間規格

1小間=9㎡ (間口3.0m×奥行3.0m×高さ2.7m) 側壁・後壁のみ設置 (角小間は側壁なし)

出展料 1小間 **440,000円** (税込) 特別協賛の法人会員*の方 1小間 **374,000円** (税込)

*切削フォーラム21の会員のみ

早期申込割引 2026年5月29日(金)までのお申込みで1小間あたり **418,000円** (税込)

特別協賛の法人会員*の方 1小間 **352,000円** (税込)

一般の10小間を超える申込の場合、下記の割合で出展料を割引します。

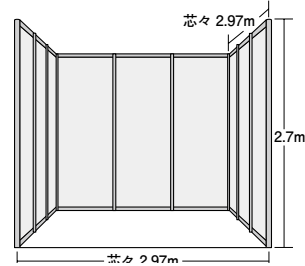
10～19小間 出展料金の5%
20小間以上 出展料金の10%

小間形態・装飾高さ制限

- 1～3小間 … 並列小間のみ
(高さ：4mまで使用可能※但し、1mセットバックした部分のみ)
- 4～9小間 … 並列小間、ブロック小間より選択可能
(高さ：4mまで使用可能 ※但し、並列小間は1mセットバック)
- 10小間以上 … 原則独立小間のみ(高さ：5mまで使用可能)
※4面開放の独立小間となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談ください。

開放面の指定

角小間指定対象1、2小間の出展者 指定料金 **55,000円** (税込)



小間のレイアウト

展示物やブースの設置方法にあわせて、並列・ブロック・独立ダブル・独立トリプル・特別アレンジの5通りの小間アレンジが可能です。

並列



独立ダブル小間 10小間以上



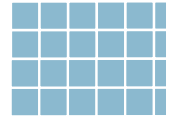
ブロック(ダブル)小間4小間以上



独立トリプル(3小間)小間 12, 15, 18小間のみ



特別アレンジ小間 20小間(180㎡)以上



出展料に含まれる費用

基準時間内の会場使用料金・照明・空調費、共有施設の工事費及び維持費、来場者プロモーション費、来場者サービスにかかわる費用 (会場案内等の制作)、会場事務局運営・安全管理・警備費用

出展料に含まれない費用

出展者の小間装飾費・搬出入費及び運営費用、電気・ガス・水道等の設備一次幹線工事及び二次側工事と使用料 (システムパッケージ申込は別途)、臨時電話等通信回線の架設費用と通信料金、出展機器及び対人傷害などの保険料、会場設備・備品及び他社展示物の破損、紛失弁償費、放置された装飾資材等の残材、ゴミ処分に係る費用、その他、通常出展料に含まない費用とみなされるもの

パッケージ装飾

※詳細・申込については、出展者説明会にてご案内いたします。
※料金は変更になる可能性があります。 ※出展料とは別に発生いたします。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

小間装飾パッケージプラン

- パラベット
- 受付カウンター
- 折りたたみ椅子 (1ケ)
- 照明 (蛍光灯20W×1+スポットライト15W×2)
- コンセント (2口) 一ヶ所 (100V-900Wまで使用可能)
- 社名表示
- カーベット
- 名刺受 (1ケ)
- 1kW以内の電気幹線工事、使用料含む
- カタログスタンド (A4/12段) (1台)

165,000円 (税込) ※出展料は除く



Bタイプ 1社1小間限定

出展小間規格

1小間=間口2.0m×奥行2.0m×高さ2.7m 一定装飾付き (角小間は側壁なし)

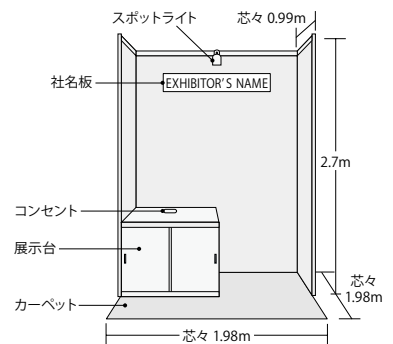
出展料 一般: **254,100円** (税込) 特別協賛の法人会員*の方 **220,000円** (税込) ※出展料、簡易装飾込み

*切削フォーラム21の会員のみ

早期申込割引 2026年5月29日(金)までのお申込みで1小間あたり **242,000円** (税込)

出展料に含まれるもの: 間口2.0m×奥行2.0mの展示スペース、間仕切り (後壁、側壁1m)、社名板、カーベット、展示台: 横幅1.0m×奥行1.0m×高さ0.8m、引き戸ユニット (鍵ナシ)、スポットライト: 22W×1、コンセント (アース付100V): 2個口×1,500Wまでの電気幹線工事費・電気使用料

※備品の追加注文がある場合は、別途ご請求させていただきます。詳しい資料は出展者説明会にてお渡しいたします。
※上記基本ディスプレイを使用しない場合も、料金を差引くことはできませんのでご了承ください。



製品・技術発表会

展示会場内の特設セミナースペースで開催する新技術・新製品PRセミナー

日時: 2027年3月10日(水)～12日(金) 10:00～17:00 内で45分間

場所: 展示会場内特設会場 (シアター形式 80名定員)

発表料金: 1セッション 55,000円 (税込)

運営方法: 1、聴講無料 (各回総入替)

2、受付・進行は発表各社が担当 (登録や名刺回収は自由です)

会場設備: 受付 (机、イス)、聴講席、演台、マイクセット、プロジェクター、スクリーン
P R: 案内状、ホームページ等に社名・プログラムを掲載

- (注) ・申込書に20字以内でセミナータイトルを記載ください。
・終了後は現状復帰をお願いいたします。
・PC使用の場合は各自お持ちください。 ※接続テスト等はこちらにご相談ください
・発表日時は主催者にて決定します。

公式 Web サイト バナー広告

貴社のリンクバナーを公式WEB (和・英) に開催1か月前から掲載

掲載期間: 2027年2月10日(水)～4月7日(水) ※予定

画像サイズ: W200px × H40px GIF形式 ※アニメーションGIF可

掲載料金: 1枠 55,000円 (税込)

原稿締切日: 2027年1月15日(金) ※リンク先指定の上、完成データをご提出ください。

会 期 2025年3月5日(水)～7日(金) 3日間 会 場 幕張メッセ 展示ホール8
出展規模 249社・団体・研究室 320小間

Grinding Technology Japan 2025 / SiC, GaN 加工技術展 2025 ▶ 登録入場者数: 合計 **6,524名**

2025年				2023年	
開催日	来場者数		天 気	開催日	来場者数
	3月5日(水)	1,786名	雨	3月8日(水)	1,426名
	3月6日(木)	2,074名	くもり	3月9日(木)	1,549名
	3月7日(金)	2,664名	晴れ	3月10日(金)	1,810名
合 計		6,524名		合 計	4,785名

※リピーター(1日に複数来場した人)は1名としてカウント。
※来場者: 展示会に来場した方。出展者は含みません。

出展者一覧

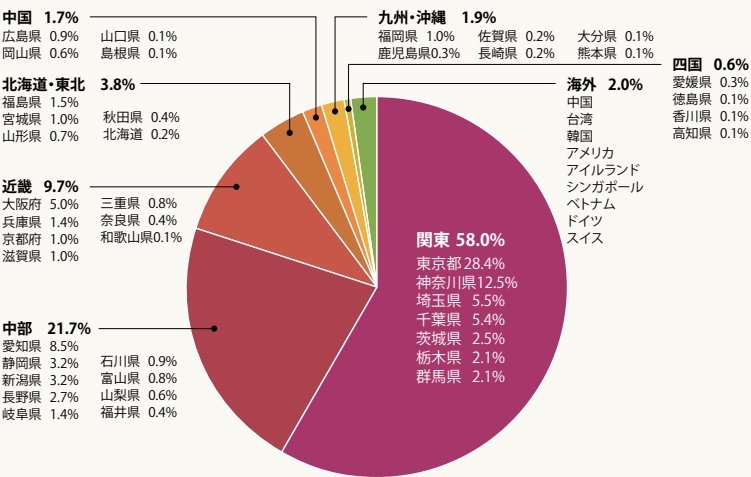
出展登録者名	出展登録者名	出展登録者名
ISBE GmbH / FDPW	株式会社ジェイテクトマシニングシステム	浜井産業株式会社
株式会社アイゼン	株式会社シギヤ精機製作所	一般社団法人バリ取り・表面仕上げ・洗浄協会
／株式会社リスモツール	シグマ電子工業株式会社	Foshan Huagao Abrasive Co.,Ltd
／シオンダイヤモンド工業株式会社	Journal of Digital Life	フォルマー・ジャパン株式会社
株式会社旭商工社	Shanxi Taiyue Abrasive Co.,Ltd.	福田交易株式会社
旭ダイヤモンド工業株式会社	CR GEMS Superabrasives Co., Ltd.	二村機器株式会社
株式会社アマダシナリー	XUCHANG GREAT ABRASIVE CO.,LTD.	プリンクマン・ポンプ・ジャパン株式会社
株式会社アライドマテリアル	株式会社潤滑通信社	プロソニック株式会社
有限会社アリューズ	株式会社スギノマシン	株式会社ブンリ
／ホーコス株式会社	住友重機械ファインテック株式会社	株式会社ポイントナイン
／株式会社イワシタ	株式会社スリーエフ技研	株式会社マイスター
アルテックス株式会社	セイコーインスツル株式会社	牧野フライス精機株式会社
株式会社石川工具研磨製作所	切削フォーラム21	株式会社ミスズ
和泉産業株式会社	CemeCon 株式会社	有限会社三井刻印
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	双龍産業株式会社	三井精機工業株式会社
入野機工株式会社	泰玉株式会社	株式会社ものづくりレビュー
宇宙経済新聞合同会社	ダイナミックツール株式会社	株式会社ヤマシタワークス
株式会社宇都宮製作所	大弥精機株式会社	／日本スピードショア株式会社
AFCジャパン株式会社	株式会社太陽工機	ユアサ商事株式会社
／ハイペリオンマテリアルズアンドテクノロジーズ ジャパン	ZHENGZHOU JIADING ABRASIVE MANUFACTURING CO., LTD	／株式会社ツガミ
株式会社エスアンドエフ	ZHENGZHOU XIANGYU NEW MATERIAL CO., LTD.	／有限会社サンメンテナンス工機
／SAV GmbH	Zhengzhou Xinli Wear-Resistant Material Co., Ltd.	／株式会社ジェイ・シー・シー
NKワークス株式会社	Zhengzhou ZZDM SUPERABRASIVES CO.,LTD	／東洋スクリーン工業株式会社
エリコンジャパン株式会社	ZHENG ZHOU SILICA NEWMATERIALCO.,LTD	ユニマグテック株式会社
株式会社オカスギ	ZHENGZHOU HEYDAY ABRASIVES CO., LTD	菱高精機株式会社
株式会社岡本工作機械製作所	Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co., Ltd	リユーベ株式会社
株式会社片桐製作所	Tyrolit Japan	／株式会社HORIKOSHI
HENAN ABRASIVESTOCKS TECHNOLOGY CO., LTD	ZOLLER Japan 株式会社	Luoyang Sunrise Abrasives Co., Ltd.
Henan SEPPE TECHNOLOGIES CO., LTD	株式会社東京精密	レッテンマイヤージャパン株式会社
HENAN KEMEI ABRASIVES CO.,LTD.	株式会社東京ダイヤモンド工具製作所	
Henan Sanhui New Materials Co.,Ltd	東昇商事株式会社	砥粒加工学会賛助会員展示コーナー
Henan HengXin Industrial&Mineral Products Co.,Ltd.	東洋研磨材工業株式会社	日本タングステン株式会社
Henan Boreas New Material Co.,Ltd	株式会社トーカロイ	中央精機株式会社
Henan Hold Diamond Technology Co., Ltd	トーマイダイヤ株式会社	ミクロン精密株式会社
Henan Yuxing Carbon Material Co., Ltd	株式会社トクビ製作所	旭ダイヤモンド工業株式会社
Henan Ruiheng New Material Co., Ltd.	トランザーフィルター日本株式会社	中村留精密工業株式会社
株式会社木村製作所	DENG FENG WUDU ABRASIVES CO., LTD.	株式会社ミズホ
株式会社キラ・コーポレーション	株式会社ナーゲル・アオブレシジョン	ノリタケ株式会社
株式会社きりしま	／ELGAN Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG	株式会社ジェイテクトグライディングツール
クール・テック株式会社	株式会社ナガセインテグレックス	牧野フライス精機株式会社
株式会社グローバルダイヤモンド	株式会社ニートレックス	富士ダイス株式会社
株式会社コイズミツール	日興キャスティ株式会社	ハイペリオン・マテリアルズ&テクノロジーズ合同会社
株式会社ゴージョー	／関西特殊工作油株式会社	オークマ株式会社
株式会社古賀	日清工業株式会社	株式会社MOLDINO
山水先端技術株式会社	日本ダイヤモンド株式会社	超音波加工技術研究所
三和クリエーション株式会社	日本ハードメタル株式会社	マコー株式会社
株式会社ジェイテクト	日本RIHON株式会社	新東工業株式会社
株式会社ジェイテクトグライディングツール	二和ダイヤモンド株式会社	株式会社アダマス

砥粒加工学会 展示コーナー

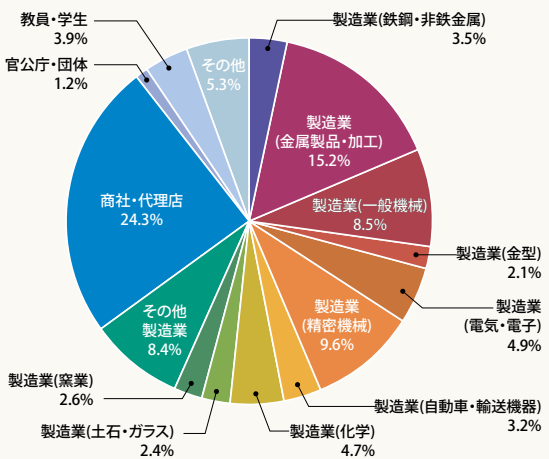
中部大学 超精密加工（鈴木）研究室	埼玉工業大学 マイクロ・ナノ工学研究室（長谷研究室）
光学部品の超精密加工	砥粒加工分野に寄与するAEセンシングとトライボロジー
日本工業大学 精密加工研究室	日本工業大学 機械加工（二ノ宮）研究室
超音波応用技術 他	レアメタル含有肉盛ドレッサによるダイヤモンド砥石の刃先高さ調整
埼玉大学 生産環境科学研究室	富山県立大学 岩井研究室
SiCの切断・研磨	環境調和型高効率・高精度加工技術
群馬大学 先端加工技術研究室	芝浦工業大学 先進製造プロセス研究センター・臨床機械加工研究室
先端加工技術とその加工現象解析	研究内容の紹介
茨城大学 n Lab（清水・小貫・尾島研究室）	中部大学 先端マイクロ加工工学研究室
次世代半導体研削と計測評価	機上工具撮影画像に基づく工具状態推定法の開発
秋田県立大学 先端加工技術研究室	岩手大学 水加工環境調和型システムネットワーク
ものづくりを加速させる高性能加工ツールの開発	環境と人にやさしい水加工システム（電気防錆加工法システム）などについて
中部大学 安達研究室	神奈川大学 中尾研究室
大径深穴内面研削スピンドル開発技術の体系的研究	スピンドルの熱的特性
足利大学 精密加工技術研究室	大阪大学 山村研究室
砥石一研削盤にわたる精密研削技術の開発研究	プラズマおよび電気化学を援用したナノ製造プロセス
防衛大学校 精密加工研究室・制御加工研究室	千葉工業大学 松井研究室
防衛大における研削・研磨加工技術高度化の取り組み	硬脆材料の研磨技術
金沢工業大学 諏訪部研究室	東京都市大学 表面加工研究室
レーザによって砥粒を固定したダイヤモンド工具の開発	噴射加工・レーザ加工・研磨加工を軸とした機能性表面創製の研究
東京電機大学 ナノ精度加工研究室	岡山大学 機械加工工学研究室
ナノ精度加工に関する研究紹介	切削・研削・砥粒加工の高度化・最適化技術の開発
佐世保工業高等専門学校 研削工具AI評価研究室	日本大学 山田・内田研究室
深層学習を用いた砥石作業面の変化形態の評価・解析	砥石表面形状に基づく研削現象の評価
東北大学 水谷・久慈研究室	立命館大学 機能表面創成工学研究室
「粘く強い」材料を「脆く弱く」変える？アモルファス合金の組織制御による革新的加工法の開発	固相電気化学プロセスが拓く環境調和型機能表面創成
関西大学 生産加工システム研究室	大阪大学 佐野研究室
研究室紹介（超精密切削、メカノケミカル複合超砥粒砥石、微小硬さ分布計測ほか）	触媒と水のみを利用した極めて環境調和性の高い半導体基板の表面加工技術
千葉大学 加工物理学研究室	
薄板ガラスの割断における亀裂進展挙動と割断面形成メカニズムに関する研究	

来場者分析

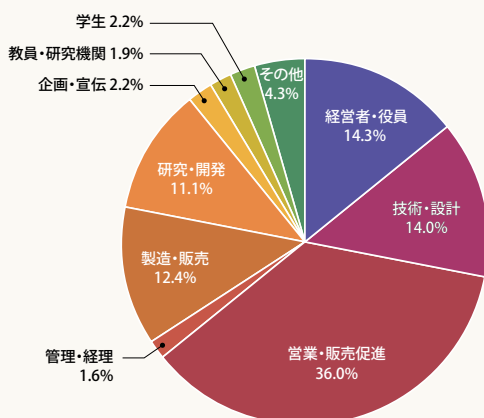
■来場者の事務所所在地別割合



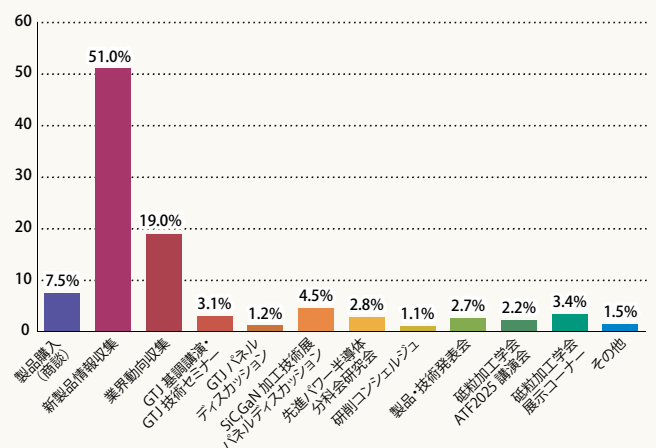
■業種



■ 職 種



■来場目的 複数回答



開催までのスケジュール(予定)

SCHEDULE

2026
5/29(金)

早期申込割引締切

2026
9/30(水)

出展申込締切

2026
12月上旬

出展者説明会

※ブースレイアウトの発表、会場構成、装飾規定、搬入・搬出などを説明します。
会場・日程など詳細は10月に出席申込企業にお知らせします。

2026
12月中

展示会案内状の完成▶配布

※出展者には無料で希望枚数を差し上げます。

2027
1月中旬

出展ブースに関わる諸申込締切 (電気、備品など)

※申込書類は出展者説明会にて配布。

2027
3/7(日)▶9(火)

展示品搬入・ブース装飾

2027
3/10(水)▶12(金)

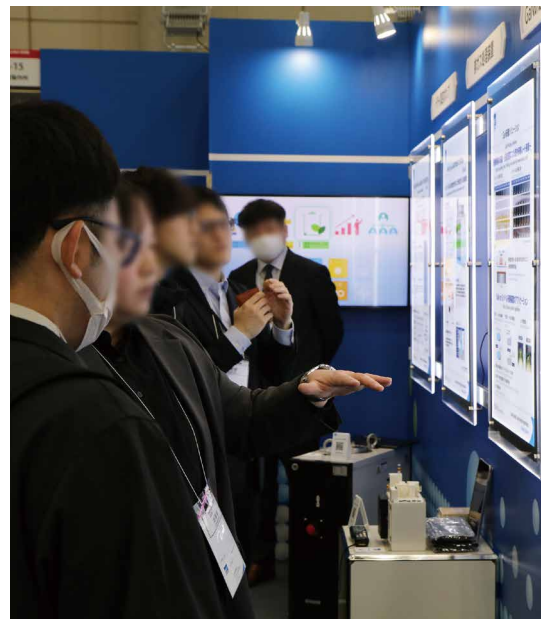
展示会開催

2027
3/12(金)▶13(土)

搬出・撤去 (3/12(金)) 17:00 ~ 21:00 / (3/13(土)) 9:00 ~ 17:00

2027
5月下旬まで

終了報告書のお届け



会場へのアクセス

幕張メッセ 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 Tel. 043-296-0001 <https://www.m-messe.co.jp>

●電車の場合

JR 京葉線



JR 総武線



●車の場合

東京都心・羽田空港方面から 約40分

湾岸習志野I.C. (東関東自動車道) から 約5分

幕張I.C. (京葉道路) から 約5分

成田空港方面から 約30分

湾岸千葉I.C. (東関東自動車道) から 約5分

お申込方法が変わりました

出展を希望される方は、公式Webサイトの出展申込フォームより必要項目をお申込みください。

出展申込締切 2026年9月30日(水)

出展申込後のキャンセルは原則としてお受けできません。ただし主催者がやむをえないと判断した場合、下記のキャンセル料をお支払いいただきキャンセルとします。

書面によるキャンセルの意思表示の期間	2026年9月30日まで出展料の50%	2026年10月1日以降出展料の100%
--------------------	---------------------	----------------------

お申込・お問合せ

産経新聞社 事業本部 コンベンション事業部「Grinding Technology Japan 2027」事務局
〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999 E-mail: gtj@sankei.co.jp

